PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-154683

(43) Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

H01L 21/304 B08B 3/08

(21)Application number: 08-327906

(71) Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22)Date of filing:

22.11.1996

(72)Inventor: NAKAGAWA YOSHIYUKI

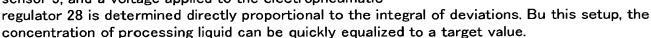
(54) SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

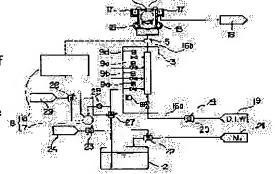
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To quickly equalize the concentration of processing liquid to a target value by a method wherein the control input of a chemical liquid control means is determined directly proportional to the deviation of a detected value, and the control input of the inert gas control means is determined directly proportional to the integral of deviations so as to control the flow rate of chemical liquid.

as to control the flow rate of chemical liquid.

SOLUTION: A concentration sensor 5 detects the mixing ratio of chemical liquid to pure water in flowing processing liquid. A concentration feedback controller 6 receives detection signals outputted from the concentration sensor 5 and outputs pressure correction signals for controlling a pressure feedback controller 7. The concentration feedback controller 6 and the pressure feedback controller 7 determine the control inputs of control objects based on a deviation obtained by subtracting a target value from an observed value. A voltage applied to an electropneumatic regulator 28 is determined directly proportional to the deviation of the detected value of the concentration sensor 5, and a voltage applied to the electropneumatic





LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of 04.03.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3537976

[Date of registration] 26.03.2004

[Number of appeal against examiner's decision of 2003-05420

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 03.04.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-154683

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

(51) Int.Cl.⁸

微別記号

FΙ

H01L 21/304

3 4 1 HO 1 L 21/304

341S

B 0 8 B 3/08

B 0 8 B 3/08

Z

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平8-327906

(22)出願日

平成8年(1996)11月22日

(71)出願人 000207551

大日本スクリーン製造株式会社

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁

目天神北町1番地の1

(72)発明者 中川 良幸

京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日

本スクリーン製造株式会社洛西事業所内

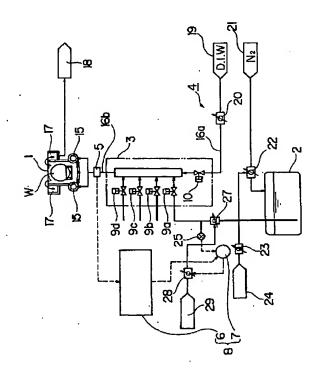
(74)代理人 弁理士 大坪 隆司

(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 処理液の濃度を速やかに目標濃度に一致させることにより、基板を精度よく処理することのできる基板処理装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 基板処理装置は、処理槽1と、薬液を加圧した状態で貯留する薬液タンク2と、複数の薬液導入弁9a、9b、9c、9dおよび純水供給弁10を有する薬液混合部3と、薬液混合部3に純水を供給するための純水供給部4と、処理槽1と薬液混合部3とを接続する供給路16a中に配設された濃度センサ5と、薬液タンク2から薬液導入弁9aに供給される薬液の圧力を制御するための耐食レギュレータ27および電空レギュレータ28と、電空レギュレータ28を制御するための濃度フィードバックコントローラ6および圧力フィードバックコントローラ7から成る制御部8とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 純水中に薬液を混合することにより生成 した処理液により基板を処理する基板処理部と、

前記基板処理部と純水の供給源とを接続する供給路と、 前記供給路中に配設され、前記供給路を通過する純水中 に薬液を混合するための薬液導入弁と、

前記供給路における前記基板処理部と前記薬液導入弁と の間に配設され、そこを通過する処理液の濃度を検出す る濃度検出手段と、

前記薬液を貯留する耐圧密閉構造の薬液タンクと、 前記薬液タンク内に不活性ガスを供給して前記薬液タン ク内の薬液を加圧することにより、薬液を前記薬液タン クから前記薬液導入弁に圧送する不活性ガス供給手段

前記薬液タンクから前記薬液導入弁に圧送される薬液の 流量を制御する薬液制御手段と、

前記濃度検出手段の検出値に基づいて前記薬液制御手段 を制御する制御部とを備え、

前記制御部は、その制御則として、前記濃度検出手段に よる検出値の偏差に比例して前記薬液制御手段の操作量 を決定する比例動作と、前記機度検出手段による検出値 の偏差の積分に比例して前記薬液制御手段の操作量を決 定する積分動作とを含むことを特徴とする基板処理装 置。

【請求項2】 純水中に薬液を混合することにより生成 した処理液により基板を処理する基板処理部と、

前記基板処理部と純水の供給源とを接続する供給路と、 前記供給路中に配設され、前記供給路を通過する純水中 に薬液を混合するための薬液導入弁と、

前記供給路における前記基板処理部と前記薬液導入弁と の間に配設され、そこを通過する処理液の濃度を検出す る濃度検出手段と、

前記薬液を貯留する耐圧密閉構造の薬液タンクと、 前記薬液タンク内に不活性ガスを供給して前記薬液タン ク内の薬液を加圧することにより、薬液を前記薬液タン クから前記薬液導入弁に圧送する不活性ガス供給手段

前記薬液タンクから前記薬液導入弁に圧送される薬液の 流量を制御する薬液制御手段と、

前記濃度検出手段の検出値に基づいて前記薬液制御手段 40 を制御する制御部とを備え、

前記制御部は、その制御則として、前記濃度検出手段に よる検出値の偏差に比例して前記薬液制御手段の操作量 を決定する比例動作と、前記濃度検出手段による検出値 の偏差の積分に比例して前記薬液制御手段の操作量を決 定する積分動作と、前記濃度検出手段による検出値の偏 差の二重積分に比例して前記薬液制御手段の操作量を決 定する二重積分動作とを含むことを特徴とする基板処理 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、半導体ウエハや 液晶表示パネル用ガラス基板あるいは半導体製造装置用 マスク基板等の基板に処理液を供給することにより、当 該基板に対して洗浄等の処理を施す基板処理装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】このような基板処理装置の一種として、 純水中に薬液を混合させることにより生成した処理液を 処理槽に供給し、この処理液中に基板を浸漬することに より当該基板を処理するものが知られている。例えば、 特開平7-22369号公報に記載された基板処理装置 は、純水の供給源から処理槽に純水を供給するための純 水供給路と、耐圧密閉構造を有し薬液を貯留する薬液タ ンクと、この薬液タンク内に圧力を制御された窒素ガス を供給する窒素ガス供給手段と、薬液タンクから純水供 給路に向けて薬液を導くための薬液の供給経路と、純水 供給路中の純水に薬液を混合させるための薬液導入弁と を備える。そして、薬液タンク内に窒素ガスを供給する ことにより薬液タンク内の薬液を加圧した後、薬液導入 弁を開放することにより、純水中に薬液を圧送し、これ により純水と薬液とを混合している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような基板処理装 置においては、薬液導入弁の流量特性が変化することに より、純水中に混合される薬液の量が変化し、その結果 処理液の濃度が変化してしまうという問題がある。すな わち、薬液の圧力や熱膨張の影響を受けて薬液導入弁が 変形した場合等においては、薬液の供給経路において薬 液が受ける圧力損失が変化し、窒素ガスにより加圧され た薬液の圧力が一定値となるように制御した場合におい ても、純水中への薬液の供給量は正確には一定とはなら ない。このため、処理槽に供給される処理液の濃度が不 均一となる。

【0004】このため、処理槽に供給される処理液の激 度等を検出し、この検出値の偏差に比例して薬液タンク に供給する窒素ガスの圧力を増減させることにより、処 理槽に供給される処理液の濃度が目標値となるように制 御することが考えられる。

【0005】しかしながら、このような制御を行った場 合においては、処理液濃度の目標値に対するオーバシュ ートが生じ、ハンチング現象により処理液の濃度が安定 するまでに長時間を要するという問題が生ずる。

【0006】処理液の濃度が不均一となった場合におい ては、その処理液により処理された基板の品質が低下 し、当該基板により製造される製品の歩留まりを低下さ せるという問題が生ずる。

【0007】この発明は上記課題を解決するためになさ れたものであり、処理液の濃度を速やかに目標濃度に一 致させることにより、基板を精度よく処理することので

きる基板処理装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、純水中に薬液を混合することにより生成した処理液 により基板を処理する基板処理部と、前記基板処理部と 純水の供給源とを接続する供給路と、前記供給路中に配 設され、前記供給路を通過する純水中に薬液を混合する ための薬液導入弁と、前記供給路における前記基板処理 部と前記薬液導入弁との間に配設され、そこを通過する 処理液の濃度を検出する濃度検出手段と、前記薬液を貯 留する耐圧密閉構造の薬液タンクと、前記薬液タンク内 に不活性ガスを供給して前記薬液タンク内の薬液を加圧 することにより、薬液を前記薬液タンクから前記薬液導 入弁に圧送する不活性ガス供給手段と、前記薬液タンク から前記薬液導入弁に圧送される薬液の流量を制御する 薬液制御手段と、前記濃度検出手段の検出値に基づいて 前記薬液制御手段を制御する制御部とを備え、前記制御 部は、その制御則として、前記濃度検出手段による検出 値の偏差に比例して前記薬液制御手段の操作量を決定す る比例動作と、前記濃度検出手段による検出値の偏差の 20 積分に比例して前記薬液制御手段の操作量を決定する積 分動作とを含むことを特徴とする。

【0009】請求項2に記載の発明は、純水中に薬液を 混合することにより生成した処理液により基板を処理す る基板処理部と、前記基板処理部と純水の供給源とを接 続する供給路と、前記供給路中に配設され、前記供給路 を通過する純水中に薬液を混合するための薬液導入弁 と、前記供給路における前記基板処理部と前記薬液導入 弁との間に配設され、そこを通過する処理液の濃度を検 出する濃度検出手段と、前記薬液を貯留する耐圧密閉構 30 造の薬液タンクと、前記薬液タンク内に不活性ガスを供 給して前記薬液タンク内の薬液を加圧することにより、 薬液を前記薬液タンクから前記薬液導入弁に圧送する不 活性ガス供給手段と、前記薬液タンクから前記薬液導入 弁に圧送される薬液の流量を制御する薬液制御手段と、 前記濃度検出手段の検出値に基づいて前記薬液制御手段 を制御する制御部とを備え、前記制御部は、その制御則 として、前記濃度検出手段による検出値の偏差に比例し て前記薬液制御手段の操作量を決定する比例動作と、前 記濃度検出手段による検出値の偏差の積分に比例して前 40 記薬液制御手段の操作量を決定する積分動作と、前記濃 度検出手段による検出値の偏差の二重積分に比例して前 記薬液制御手段の操作量を決定する二重積分動作とを含 むことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は、この発明に係る基板処理装置の概要図である。

【0011】この基板処理装置は、基板Wを処理するための基板処理部としての処理槽1と、薬液を貯留する薬 50

液タンク2と、複数の薬液導入弁9a、9b、9c、9dおよび純水供給弁10を有する薬液混合部3と、薬液混合部3に純水を供給するための純水供給部4と、処理槽1と薬液混合部3とを接続する供給路16a中に配設された濃度センサ5と、濃度フィードバックコントローラ6および圧力フィードバックコントローラ7とから成る制御部8とを備える。

【0012】処理槽1は、例えばその材質が石英により構成され、そこに貯留した処理液中に基板Wを浸漬して処理するものである。この処理槽1の底部には処理槽1内に処理液を噴出するための多数の噴出孔を穿設した一対の噴出ノズル15が配設されており、この一対の噴出ノズル15は供給路16bと接続されている。また、処理槽1の周囲には処理槽1の上端からオーバフローする処理液を回収するための回収部17が配設されており、この回収部17はドレイン18と接続されている。

【0013】薬液タンク2は耐圧密閉構造を有し、窒素ガス供給源21と耐食レギュレータ22を介して接続されている。また、この耐食レギュレータ22のパイロットポートはレギュレータ23を介して圧縮空気供給源24と接続されている。

【0014】上記耐食レギュレータ22は、そのパイロットポートに供給される空気の圧力に対応させてそこを通過する窒素ガスの圧力を制御するものである。また、上記レギュレータ23は、そこを通過する圧縮空気の圧力を一定圧力に制御するものである。これらの耐食レギュレータ22およびレギュレータ23の作用により、薬液タンク2に供給される窒素ガスの圧力を一定圧力に制御することが可能となる。

【0015】薬液タンク2と薬液混合部3との間には耐食レギュレータ27が配設されている。また、この耐食レギュレータ27のパイロットポートは電空レギュレータ28を介して圧縮空気供給源29と接続されている。

【0016】上記耐食レギュレータ27は、そのパイロットポートに供給される空気の圧力に対応させてそこを通過する薬液の圧力を制御するものである。また、上記電空レギュレータ28は、圧力フィードバックコントローラ7から印加される電圧に対応させてそこを通過する圧縮空気の圧力を制御するものである。これらの耐食レギュレータ27および電空レギュレータ28の作用により、薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の流量を制御することが可能となる。

【0017】なお、上記のようにレギュレータを2段階に配置した構成をとるかわりに、窒素ガス供給源21と薬液タンク2との間や薬液タンク2と薬液混合部3との間に単一のレギュレータを配設して窒素ガスまたは薬液の圧力を当該レギュレータにより制御することも可能である。但し、フッ酸等のその蒸気が腐食性を有する薬液を使用する場合においては、上記のような構成をとることが好ましい。

【0018】純水供給部4は、薬液混合部3の純水供給 弁10と純水供給源19とを接続する供給路16aと、 供給路16a中に配設された純水レギュレータ20とを 備える。純水供給源19より供給された純水は、純水レ ギュレータ20により一定の流量に調整され、供給路1 6aを介して薬液混合部3の純水供給弁10に供給され る。

【0019】濃度センサ5は、供給路16bを通過する処理液の濃度を検出するためのものである。すなわち、供給路16bを通過する処理液は純水中に薬液を混合することにより生成されたものであるが、濃度センサ5は、そこを通過する処理液における純水に対する薬液の割合(重量パーセント)を検出するものである。この濃度センサ5としては、例えば、処理液の導電率から処理液の濃度を検出するものや処理液の光の透過率から処理液の濃度を検出するものを使用することができる。

【0020】薬液混合部3は、図2に示すように、本体44の内部に直線状の流体通路45を有する。そして、この流体通路45は、純水供給源19から薬液混合部3に至る供給路16aと、薬液混合部3から処理槽1に至20 る供給路16bとに接続されている。供給路16aから供給される純水は、純水供給ポート47を通って流体通路45内に進入する。また、純水供給ポート47の下流側には、排液管49に接続する排液ポート48が配設されている。これらの純水供給ポート47および排液ポート48は、各々純水供給弁10および排液弁50により開閉制御される。なお、図1においては、排液管49および排液弁50は、図示を省略している。

【0021】流体通路45の内壁には、4個の薬液導入 弁9a、9b、9c、9dの二次側流路が開口してい る。また、本体44の側面には薬液導入口46a、46 b、46c、46d(図3においては46dのみ図示している)が形成されている。これらの薬液導入口46a は、前述した薬液タンク2と接続されており、薬液タンク2内の薬液は薬液導入口46a は、前述した薬液タンク2と接続されており、薬液タンク2内の薬液は薬液導入口46aを介して流体通路45 中の純水に混合される。また、他の薬液導入口46b、 46c、46dは、各々、図示を省略した他の薬液タンク等より成る薬液供給部と接続されており、薬液タンク 2内の薬液とは異なる薬液の供給を受け、その薬液を流 体通路45中の純水に混合する。

【0022】なお、この実施の形態においては、薬液導入口46aと接続する薬液タンク2にはフッ化水素が貯留されている。また、各薬液導入口46b、46c、46dと接続する薬液タンクには、各々、アンモニア、塩酸、過酸化水素が貯留されている。そして、基板Wに対しフッ酸によるエッチングを行う場合においては、純水供給弁10とを開放して薬液混合部3の流体通路45内に純水を供給すると共に、薬液導入弁9aを開放して窒素ガスにより加圧され圧送された薬液タンク2内のフッ

化水素を流体通路 4 5 内に導入する。同様に、基板Wに対し通常 S C 1 と呼称される洗浄処理を行う場合においては、純水供給弁 1 0 とを開放して流体通路 4 5 内に純水を供給すると共に、薬液導入弁 9 b および 9 d を開放してアンモニアと過酸化水素を流体通路 4 5 内に導入する。さらに、基板Wに対し通常 S C 2 と呼称される洗浄処理を行う場合においては、純水供給弁 1 0 とを開放して流体通路 4 5 内に温純水を供給すると共に、薬液導入弁 9 c および 9 d を開放して塩酸と過酸化水素を流体通路 4 5 内に導入する。

【0023】制御部8は、濃度フィードバックコントローラ6と圧力フィードバックコントローラ7とから構成される。

【0024】 濃度フィードバックコントローラ6は、濃度センサ5の検出信号を受け、圧力フィードバックコントローラ7を制御する制御信号としての圧力補正信号を出力するためのものである。また、圧力フィードバックコントローラ7は、薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の圧力を検出する圧力トランスデューサ25からの検出信号と濃度フィードバックコントローラ6からの圧力補正信号とを受け、純水中に混合される薬液の量を制御するためのものである。すなわち、圧力フィードバックコントローラ7は、電空レギュレータ28に印加する電圧を制御することにより、電空レギュレータ28に印加する電圧を制御することにより、電空レギュレータ28は入び耐食レギュレータ27を介して薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の流量を制御する。

【0025】これらの濃度フィードバックコントローラ 6 および圧力フィードバックコントローラ 7 は、目標値 から観測量(検出値)を減算した偏差に基づいて制御対象の操作量を決定するための制御方式として、PID制 御を採用する。このPID制御とは、比例動作(P動作)、積分動作(I動作)、微分動作(D動作)を含む制御則であり、3項制御とも呼称される。このPID制御は、制御対象の制御量(すなわち制御後の観測量)を速やかに目標値に近づけることができるという特徴を有する。

【0026】すなわち、偏差が小さければ操作量も小さく偏差が大きくなればそれに応じて操作量も大きくするのが妥当であることから、制御則には偏差に比例する項を含める。これを比例動作(P動作)という。また、自己平衡性をもつ制御対象に比例制御のみを行うと、目標値や外乱のステップ状変化に対して最終的に、定常偏差(オフセット)と呼称される一定の偏差が残ってしまう。この定常偏差は、偏差の積分に比例する項を制御則に含めることで除去することができる。これを積分動作(I動作)という。さらに、本実施の形態では偏差の微分に比例する項も制御則に含める。これを微分動作(D動作)という(株式会社朝倉書店発行/PID制御第3

頁参照)。これは一種の予見動作であり、この動作を含めることによって、偏差の増減の動向を操作量の決定に 反映して制御特性の改善を図ることができる。

【0027】従って、このPID制御を利用し、濃度センサ5による検出値の偏差に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する比例動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の積分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する積分動作と、さらに濃度センサ5による検出値の偏差の微分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する微分動作とをおったりにより処理液の濃度を制御することで、薬液導入弁9aの流量特性が変化した場合等においても、処理液の濃度を速やかに目標濃度に一致させることが可能となる。

【0028】以下、濃度フィードバックコントローラ6 および圧力フィードバックコントローラ7からなる制御部8により、処理液の濃度を制御する動作について説明する。図3は、上述した濃度フィードバックコントローラ6および圧力フィードバックコントローラ7の機能を模式的に示すブロック図である。

【0029】この図に示すように、濃度フィードバックコントローラ6は、濃度/流量変換部31と、流量/圧力変換部32と、PIDコントローラ33とを備える。

【0030】予め設定された濃度設定値C1から濃度センサ5による実際の処理液の濃度のフィードバック値C2を減算することにより得られた濃度制御偏差Chfeは、濃度/流量変換部31に入力され、濃度/流量変換部31において流量制御偏差Qhfeに変換される。この変換時には、薬液混合部3に供給される純水の流量が参照される。そして、この流量制御偏差Qhfeは、流 30量/圧力変換部32に入力され、流量/圧力変換部32において圧力補正値Pcに変換される。この圧力補正値Pcは、PIDコントローラ33に入力される。

【0031】PIDコントローラ33においては、比例動作(P動作)、積分動作(I動作)、微分動作(D動作)を行うことにより、この圧力補正値Pcに基づいて圧力補正信号を作成する。

【0032】すなわち、比例動作(P動作)においては、圧力補正値Pcに比例ゲインKpcを乗算し、この乗算結果を作業用変数wk0として記憶する。また、積分動作(I動作)においては、圧力補正値Pcにサンプリング時間Tsを乗算したものを圧力補正値の積分値Pcitとし、この圧力補正値の積分値Pcitとし、この圧力補正値の積分値Pcitに積分ゲインKicを乗算したものを先の作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0とする。さらに、微分動作(D動作)においては、圧力補正値Pcと1サンプリング前の圧力補正値Pcoとの差をサンプリング時間Tsで除算したものに微分ゲインKdcを乗算し、これを先の作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0とす

る。また、圧力補正値Pcを圧力補正値Pcのに変更する。ここで作成された作業用変数wk0は、圧力補正信号として使用される。

【0033】圧力フィードバックコントローラ7は、濃度フィードバックコントローラ6により作成された圧力補正信号としての作業用変数wk0を利用して電空レギュレータ28を制御する制御電圧を作成するためのものであり、PIDコントローラ34とフィードフォワード制御部35とを備える。

【0034】予め設定された圧力設定値P1に、圧力補正信号としての作業用変数wk0を加算して補正済圧力設定値P4を得る。さらにP4から圧力トランスデューサ25で検出した薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の圧力値P2を減算することにより圧力制御偏差Peを得る。そして、この圧力制御偏差PeはPIDコントローラ34に入力される。

【0035】PIDコントローラ34においては、比例動作(P動作)、積分動作(I動作)、微分動作(D動作)を行うことにより、圧力制御偏差Peに基づいて電空レギュレータ28を制御する制御電圧の作成に利用される作業用変数wk1を作成する。

【0036】すなわち、比例動作(P動作)においては、圧力制御偏差Peに比例ゲインKpを乗算し、この乗算結果を作業用変数wklとして記憶する。また、積分動作(I動作)においては、圧力制御偏差Peにサンプリング時間Tsを乗算したものを圧力制御偏差の積分値Pitに加算して新たな圧力制御偏差の積分値Pitに積分ゲインKiを乗算したものを先の作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklとする。さらに、微分動作(D動作)においては、圧力制御偏差Peoとの差をサンプリング時間Tsで除算したものに微分ゲインKdを乗算し、これを先の作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに加算して新たな作業用変数wklに列

【0037】一方、フィードフォワード制御部35においては、補正済圧力設定値P4を電空レギュレータ28を制御する制御電圧の作成に利用される出力値P3に変換する。そして、PIDコントローラ34において作成された作業用変数wk1と出力値P3とを加算することにより、電空レギュレータ28を制御する制御電圧が作成される。

【0038】なお、図3におけるSW1はPIDコントローラ33を動作させるか否かを選択するスイッチであり、SW2はPIDコントローラ34を動作させるか否かを選択するスイッチである。スイッチSW1は、処理液が濃度センサ5を通過していないにもかかわらず濃度センサ5による濃度のフィードバック値C2に基づいてPIDコントローラ33が制御動作を行うことを防止す

るため、基板Wの処理を開始して処理液が濃度センサ5を通過しているときのみ閉じられる。また、スイッチSW2は、薬液供給開始時に、薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の圧力を設定圧力値P1付近まで上昇させた後に閉じられる。このことにより、薬液供給開始時に発生し易い圧力のオーバシュートを防止し、設定圧力値への到達を速めることができる。

【0039】上述した基板処理装置により基板Wを処理する場合においては、圧力設定値P1に対応する出力値P3を電空レギュレータ28に印加することにより、耐食レギュレータ27を介して薬液タンク2から薬液混合部3に供給される薬液の流量を制御する。そして、薬液混合部3の純水供給弁10を開放すると共に薬液導入弁9aを開放することにより純水中に薬液を混合し、これにより生成された処理液を供給路16bを介して処理槽1中に供給する。

【0040】続いて、濃度フィードバックコントローラ6と圧力フィードバックコントローラ7とから構成された制御部8により、濃度センサ5で検出した処理液の濃度に基づいて電空レギュレータ28を制御して処理槽1に供給される処理液の濃度を目標濃度に一致させる。このとき、濃度センサ5による検出値の偏差に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する比例動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の積分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する積分動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の微分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する微分動作とを含む制御則により処理液の濃度を制御していることから、処理液の濃度を速やかに目標濃度に一致させることが可能となる。

【0041】そして、図示しない基板搬送装置により、 複数の基板Wを処理槽1に貯留された処理液中に浸漬し て基板Wの処理を行う。

【0042】次に、この発明の第2の実施形態について 説明する。図4は、第2実施形態に係る濃度フィードバックコントローラ26および圧力フィードバックコント ローラ7の機能を模式的に示すブロック図である。な お、図3に示す実施形態と同一の部材については、同一 の符号を付して詳細な説明を省略する。

【0044】 すなわち、第1実施形態に係るPIDコントローラ33においては、比例動作 (P動作)、積分動作 (I動作)、微分動作 (D動作)を含むPID制御を利用しているが、このPII² Dコントローラ53においては、さらに二重積分動作 (I² 動作)を追加してい 50

る。より具体的には、濃度センサ5による検出値の偏差に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する比例動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の積分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する積分動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の二重積分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する二重積分動作と、濃度センサ5による検出値の偏差の微分に比例して電空レギュレータ28に印加する電圧を決定する微分動作とを含む制御則により処理液の濃度を制御するものである。

【0045】PII² Dコントローラ53においては、 図3に示すPIDコントローラ33と同様、圧力補正値 Pcに基づいて圧力補正信号を作成する。

【0046】すなわち、比例動作 (P動作) において は、圧力補正値Pcに比例ゲインKpcを乗算し、この 乗算結果を作業用変数wk0として記憶する。また、積 分動作 (I動作) においては、圧力補正値 P c にサンプ リング時間Tsを乗算したものを圧力補正値の積分値P c i t に加算して新たな圧力補正値の積分値 P c i t と し、この圧力補正値の積分値Pcitに積分ゲインKi cを乗算したものを先の作業用変数wkOに加算して新 たな作業用変数wk0とする。また、二重積分動作(Ⅰ ² 動作)においては、圧力補正値の積分値Pcitにサ ンプリング時間 Tsを乗算したものを圧力補正値の二重 積分値Pcittに加算して新たな圧力補正値の二重積 分値Pcittとし、この圧力補正値の二重積分値Pc i t tに二重積分ゲインKiicを乗算したものを先の 作業用変数wk0に加算して新たな作業用変数wk0と する。さらに、微分動作(D動作)においては、圧力補 正値 P c と 1 サンプリング前の圧力補正値 P c o との差 をサンプリング時間Tsで除算したものに微分ゲインK d c を乗算し、これを先の作業用変数wk 0に加算して 新たな作業用変数wk0とする。また、圧力補正値Pc を圧力補正値 P c o に変更する。ここで作成された作業 用変数wk0は、圧力補正信号として使用される。

【0047】このPII² Dコントローラ53を有する 濃度フィードバックコントローラ26を使用した場合に おいては、処理槽1に処理液の供給を開始した直後の過 渡的状態に発生する偏差を、偏差の二重積分に比例する 項を制御則に含めることで除去することができる。 従って、このPII² Dコントローラ53を有する濃度フィードバックコントローラ26を使用した場合においては、PIDコントローラ33を有する濃度フィードバックコントローラ6を使用した場合の効果に加え、処理槽1に処理液の供給を開始した直後の過渡的状態をも含めて、処理液供給時間全域に直る処理液濃度の平均値を目標濃度と一致させることができる。

【0048】上述した実施の形態においては、純水供給 部19から薬液混合部3に供給する純水を供給路16a 中に配設した純水レギュレータ20によって一定の圧力 に制御する場合について説明したが、この純水の圧力をフィードバック制御によって一定値に維持するようにしてもよい。但し、この実施の形態においては、処理槽1に供給される処理液の濃度を濃度センサ5で確認する構成をとることがら、薬液混合部3に供給される純水の圧力が多少変化した場合であっても、処理液の濃度を一定に維持することができる。

【0049】また、上述した実施の形態においては、制御部8を構成する濃度フィードバックコントローラ6、26と圧力フィードバックコントローラ7とを個別に設け、これらをカスケード接続する場合について説明したが、これらを一体化した複数入出力構成の制御部を使用してもよい。また、濃度フィードバックコントローラ6、26や圧力フィードバックコントローラ7にかえて、同様の機能を実現するファジイ制御やニューラルネットワーク等を利用してもよい。なお、上述した実施の形態においては、圧力フィードバックコントローラ7もPID制御を利用しているが、圧力フィードバックコントローラ7については他の制御方式を採用してもよい。

【0050】また、上述した実施の形態においては、一つの薬液タンク2から単一の処理槽1に薬液を供給する場合について説明したが、一つの薬液タンク2から複数の処理槽に処理液を供給するようにしてもよい。この場合においては、薬液タンク2、耐食レギュレータ22およびレギュレータ23等を複数の処理槽で共有することができることから、基板処理装置を小型化し、また、装置自体のコストを低減することが可能となる。

【0051】さらに、上述した実施の形態においては、基板Wとして略円形の半導体ウエハを使用し、この基板Wを処理槽1に貯留された処理液中に浸漬してその処理 30を行う基板処理装置にこの発明を適用した場合について説明したが、処理液を基板Wに塗布または噴出して処理する方式の基板処理装置にこの発明を適用してもよく、また、液晶表示パネル用ガラス基板あるいは半導体製造装置用マスク基板等の基板を処理する基板処理装置にこの発明を適用してもよい。

[0052]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、濃度検出手段による検出値の偏差に比例して薬液制御手段の操作量を決定する比例動作と、濃度検出手段による検出値の偏差の積分に比例して薬液制御手段の操作量を決定する積分動作とを含む制御則により薬液導入弁に供給される薬液の流量を制御することから、薬液導入弁の流量特性が変化した場合等においても、処理液の濃度を速やかに目標濃度に一致させることが可能となり、基板を精度よく処理することができる。

【0053】請求項2に記載の発明によれば、濃度検出 手段による検出値の偏差に比例して薬液制御手段の操作 量を決定する比例動作と、濃度検出手段による検出値の 偏差の積分に比例して薬液制御手段の操作量を決定する 積分動作と、濃度検出手段による検出値の偏差の二重積 分に比例して薬液制御手段の操作量を決定する二重積分 動作とを含む制御則により薬液導入弁に供給される薬液 の流量を制御することから、薬液導入弁の流量特性が変 化した場合等においても、処理液の濃度を速やかに目標 濃度に一致させることが可能となり、さらには、基板処 理部に処理液の供給を開始した直後の過渡的状態をも含 めて、処理液供給時間全域に直る処理液濃度の平均値を 目標濃度と一致させることができる。このため、基板を より精度よく処理することができる。

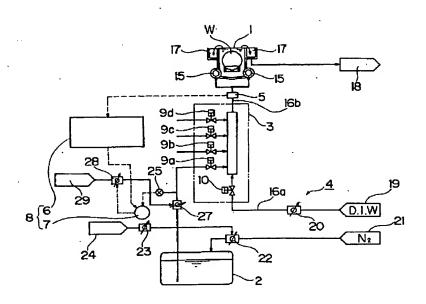
【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明に係る基板処理装置の概要図である。
- 【図2】薬液混合部3の断面図である。
- 【図3】第1実施形態に係る制御部8の機能を模式的に 示すプロック図である。
- 【図4】第2実施形態に係る制御部8の機能を模式的に 示すブロック図である。

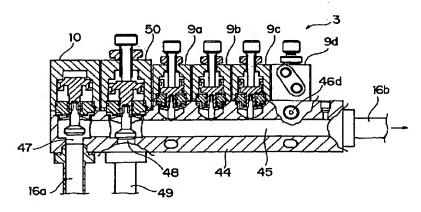
【符号の説明】

- 1 処理槽
- 2 薬液タンク
- 3 薬液混合部
- 4 純水供給部
- 5 濃度センサ
- 6 濃度フィードバックコントローラ
- 7 圧力フィードバックコントローラ
- 8 制御部
- 9 a 薬液導入弁
- 10 純水導入弁
- 16a 供給路
- 16b 供給路
- 19 純水供給源
- 20 純水レギュレータ
- 21 窒素ガス供給源
- 22 耐食レギュレータ
- 23 レギュレータ
- 24 圧縮空気供給源
- 25 圧力トランスデューサ
- 26 濃度フィードバックコントローラ
 - 27 耐食レギュレータ
 - 28 電空レギュレータ
 - 29 圧縮空気供給源
 - 33 PIDコントローラ
- 34 PIDコントローラ
- 53 PII² Dコントローラ
- W 基板

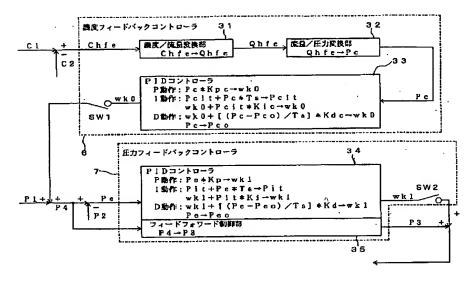
【図1】



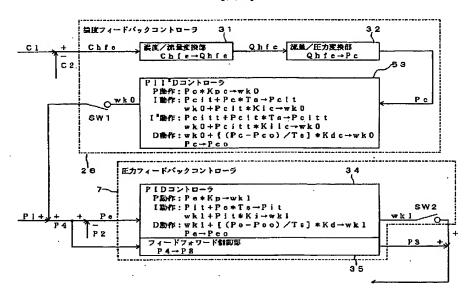
【図2】



【図3】



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
✓ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.